

## 智能外控集成 LED 光源

#### 主要特点

- 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
- 12V供电电压,有效降低整个像素点的工作电流,降低线路板压降,最大限度保证像素点在很远距离传输时达到良好的混光一致性。
- 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。
- 端口扫描频率2KHz。
- 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 断点续传,额外增加一路信号线,实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体显示效果
- 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致,性价比高。

#### 主要应用领域

- LED全彩发光字灯串,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
- LED点光源, LED像素屏, LED异形屏。

#### 产品概述

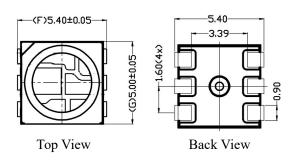
WS2815-MINI是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振荡器和高精度恒流控制模块,有效保证了像素点光的颜色高度一致。实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下,不影响整体色彩的显示。

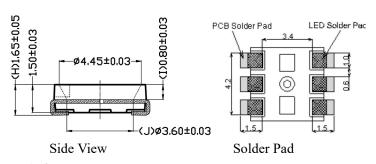
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。

BIN端接收到数据信号吞噬24bit数据后,和DIN端数据比较,若DIN端无信号,BIN端有接收到信号,切换到BIN端接收输入信号,确保其中一个IC的损坏不会影响信号的级联传输,控制IC保持在BIN端口接收状态,直到断电后的下次开机重新确认。

高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280 μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。

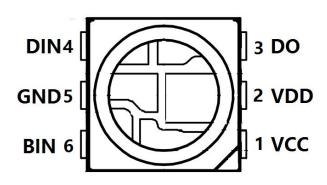
### 机械尺寸(单位mm)







## 引脚图



#### 引脚功能

序号	符号	管脚名	功 能 描 述
1	VCC	IC 供电电源	PCB LAYOUT 时可以悬空或对地接一个滤波电容
2	VDD	LED 供电电源	电源供电脚,接 +12V 工作电源
3	DO	主数据输出	控制数据信号输出脚
4	DIN	主数据输入	控制数据信号输入脚
5	GND	地线	信号接地和电源接地脚
6	BIN	辅数据输入	辅助数据信号输入脚

## **最大额定值(**如无特殊说明,T<sub>A</sub>=25℃,V<sub>SS</sub>=0V)

参数	符号	范围	单位
电源电压	$V_{DD}$	+9.5~+13.5	V
逻辑输入电压	V <sub>I</sub>	-0.5~VCC+0.5	V
工作温度	Topt	-25~+ <del>8</del> 5	${\mathbb C}$
储存温度	Tstg	-40~+105	${\mathbb C}$

## **电气参数(**如无特殊说明,T<sub>A</sub>=-20~+70℃,V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V,V<sub>SS</sub>=0V**)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输入电流	$I_{I}$			±1	μΑ	$V_I = V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入	$V_{\mathrm{IH}}$	$0.7V_{\mathrm{DD}}$			V	D <sub>IN</sub> , SET
低电平输入	V <sub>IL</sub>			$0.3~\mathrm{V_{DD}}$	V	D <sub>IN</sub> , SET
滞后电压	$V_{\mathrm{H}}$		0.35		V	D <sub>IN</sub> , SET

# 智能外控集成 LED 光源

#### **开关特性(**如无特殊说明, T<sub>A</sub>=-20~+70℃, V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V, V<sub>SS</sub>=0V**)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
传输延迟时间	$t_{PLZ}$			300	ns	CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ
下降时间	t <sub>THZ</sub>			120	μs	CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	$C_{I}$			15	pF	

#### LED 特性参数

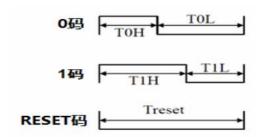
	WS2815
静态电流	2.1mA
RGB 通道恒流	15mA
红光亮度(中心值)	360mcd
绿光亮度(中心值)	1150mcd
蓝光亮度(中心值)	220mcd
白光亮度(中心值)	1710mcd
红光波长	620-625nm
绿光波长	515-525nm
蓝光波长	465-475nm

## 数据传输时间

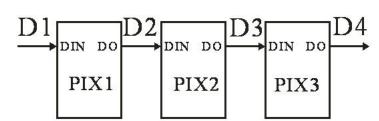
ТОН	0 码, 高电平时间	220ns~380ns
T1H	1码, 高电平时间	580ns~1.6μs
T0L	0 码, 低电平时间	580ns~1.6μs
T1L	1码, 低电平时间	220ns~420ns
RES	帧单位,低电平时间	280µs 以上

## 时序波形图

#### 输入码型:



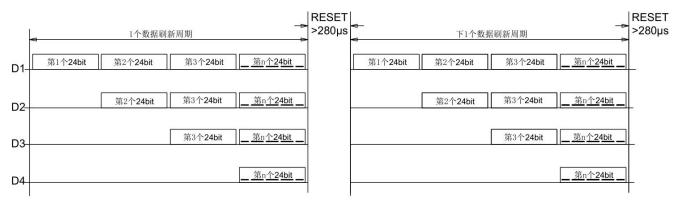
#### 连接方法:





# 智能外控集成 LED 光源

#### 数据传输方法



注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

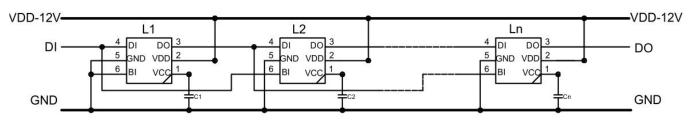
#### 24bit 数据结构

R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	В0
																							1

注: 高位先发, 按照 RGB 的顺序发送数据。

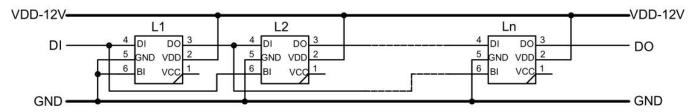
### 典型应用电路图

1、推荐应用电路图



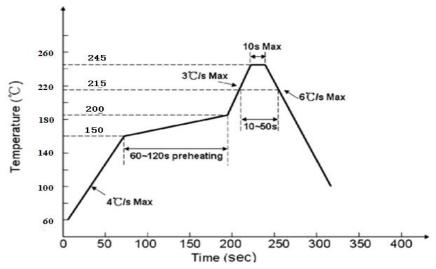
注: C1 为 IC 旁路滤波电容。

2、由于 WS2815 内封电容,对于 PCB 走线比较复杂的线路,可以使用如下电路图,以节省布线空间





#### 无铅回流焊指引



曲线说明	无铅回流焊
最低预热温度(Tsmin)	150℃
最高预热温度(Tsmax)	200℃
预热区时间(Tsmin to Tsmax)(ts)	60-180 S
平均升温速率(Tsmax to Tp)	<3°C/S
液相温度(TL)	217℃
液相区保温时间(tL)	60-150 S
峰值温度(Tp)	245℃
高温区(峰值温度-5℃)停留时间(tp)	<10 S
降温速率	<6°C/S
室温至峰值温度停留时间	<6 min

### 回流焊说明

- 1. 回流焊不可以做两次以上
- 2. 当回焊时,不要在材料受热时用力压胶体表面

## 烙铁焊接说明

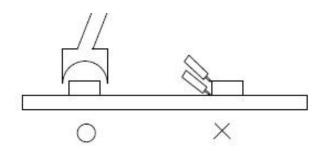
- 1. 当手工焊接时,烙铁的温度必须小于300℃,时间不可超过3秒
- 2. 手工焊接只可焊接一次



## 智能外控集成 LED 光源

## 修补说明

LED 回流焊后不应该修补,当修复是不可避免时,必须使用双头烙铁(如下图),但必须事先确认此种方式会或不会损坏 LED 本身的特性。



#### 运输及存储

#### 1. 运输及适用范围

所有产品在运输过程中, 需保持正面朝上, 防潮防水, 运输过程中逼免挤压、碰撞和剧烈震动。

#### 2. 产品储存及期限

室温密封存储: 20 ℃  $\sim$  30 ℃ , 40%  $\sim$  60%RH , 产品有效期为 1 周; 防潮密封存储: 20 ℃  $\sim$  30 ℃ , 25%  $\sim$  60%RH , 产品有效期为 2 周; 产品拆包开封后 , 建议 2 小时内使用完成 , (环境条件温度 < 30 ℃ , 湿度 < < 60 %)。

#### **3.** 除湿处理

LED 产品超出以上规定期限,或者由于其他原因受潮,建议客户做除湿处理后再使用。除湿方法: 70  $\mathbb{C}$  -75  $\mathbb{C}$  /48±2 小时。

#### 4. 静电防护

LED 是静电敏感器件,虽然 LED 产品具有优异的抗静电能力,但每经历一次静电释放产生的冲击, 都会对 LED 造成一定程度的损坏。因而在使用 LED 产品过程中需要做好静电防护措施, 例如佩戴防静电手套及防静电手环等。

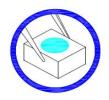


## 智能外控集成 LED 光源

#### 注意事项

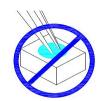
LED 封装为硅胶,用力按压胶体表面会影响 LED 可靠性,因此应有预防措施避免在封装的零件上的强大压力,当使用吸嘴时,胶体表面的压力应是恰当的。硅胶封装较柔软且有弹性,因它的特性大大减少了热应力,易受机械外力损坏,因此在手工处理方面须要对硅胶封装材料做预防措施,若未按要求操作,可能会导致 LED 损坏和光衰。

1. 通过使用适当的工具从材料侧面夹取



2. 不可直接用手或尖锐金属压胶体表面,它可能会损坏内部电路





3. 不可将模组材料堆积在一起,它可能会损坏内部电路



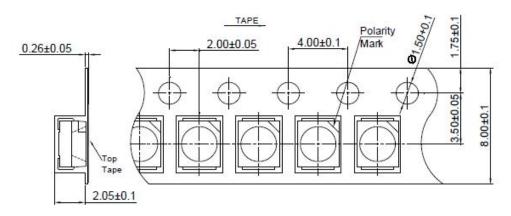
4. 不可用在 PH<7 的酸性场所



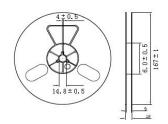


# 智能外控集成 LED 光源

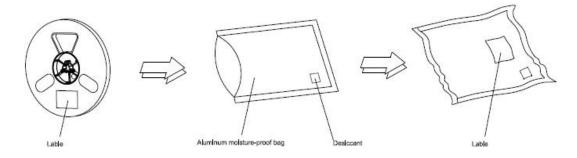
## 载带规格 (单位: mm)



## 卷轴尺寸



## 防潮袋包装



## 文件更改记录

版本号	状态	修改内容概要	修订日期	修订人	批准人
V1.0	N	新建			

注: 初始版本号V1.0; 每次修订批准后, 版本号顺序加"0.1";

状态包括: N--新建, A--增加, M--修改, D--删除。